



Final Product/Process Change Notification

Document #: FPCN23381X

Issue Date: 05 Aug 2020

Title of Change:	Qualification to change epoxy from dispensing QMI519 and ABLETHERM 8600 to CDAF215 at HANA Semiconductor.	
Proposed First Ship date:	12 Nov 2020 or earlier if approved by customer	
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or Naruedol.Srisamran@onsemi.com	
PCN Samples Contact:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or PCN.samples@onsemi.com Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.	
Additional Reliability Data:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or Lalan.Ortega@onsemi.com	
Type of Notification:	This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. FPCNs are issued 90 days prior to implementation of the change. ON Semiconductor will consider this change accepted, unless an inquiry is made in writing within 30 days of delivery of this notice. To do so, contact PCN.Support@onsemi.com	
Marking of Parts/ Traceability of Change:	There is no product marking change as a result of this change	
Change Category:	Assembly Change	
Change Sub-Category(s):	Material Change	
Sites Affected:		
ON Semiconductor Sites	External Foundry/Subcon Sites	
None	HANA Semiconductor, Thailand	
Description and Purpose:		
ON Semiconductor would like to inform customers for the change in epoxy material including the process flow for support this material change as following table.		
The others material is the same :		
	Before Change Description	After Change Description
Die Attach	QMI519 or ABLETHERM 8600	CDAF215
Other Changes	Dispensing epoxy at Die attach process	DAF laminate at Wafer Backgrinding process
There is no product marking change as a result of this change.		

**Reliability Data Summary:**

QV DEVICE NAME: FDMC2523P

RMS : F60209

PACKAGE : WDFN8

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008hrs	0 / 231
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	96 hrs	0 / 231
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2.0 min	30,000 cycles	0 / 231
TC	JESD22-A104	Ta= -65°C to +150°C	500 cyc	0 / 231
AC	JESD22-A102	121°C, 100% RH, 15.5psig, unbiased	96 hrs	0 / 231
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C		0 / 924
RSH	JESD22- B106	Ta = 265°C, 10 sec		0 / 90
SD	JSTD002	Ta = 245°C, 10 sec		0 / 45
SAT	JEDEC STD 035	Pre and Post MSL 1		0 / 22
CDPA X Section	AEC- 006	Custom Destructive Physical Analysis – X section		0 / 6
DPA	AEC Q101	Destructive Physical Analysis post HAST 192hrs, TC 1000cycles		0 / 12

QV DEVICE NAME: FDMA1032CZ

RMS : F60218

PACKAGE : WDFN6

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	2016 hrs	0 / 77
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs	0 / 77
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2.0 min	30,000 cycles	0 / 77
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	2000 cyc	0 / 77
AC	JESD22-A102	121°C, 100% RH, 15.5psig, unbiased	96 hrs	0 / 77
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C		0 / 308
RSH	JESD22- B106	Ta = 265°C, 10 sec		0 / 30
SD	JSTD002	Ta = 245°C, 10 sec		0 / 15
SAT	JEDEC STD 035	Pre and Post MSL 1		0 / 22
CDPA X Section	AEC- 006	Custom Destructive Physical Analysis – X section		0 / 2
CDPA WP	MILSTD750 Method 2037	Wire Pull after TC1000 cycles, Cu wire		0 / 5
DPA	AEC Q101	Destructive Physical Analysis post HAST 192hrs, TC 1000cycles		0 / 4



Electrical Characteristics Summary:

Electrical characteristics are not impacted.

List of Affected Parts:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the **PCN Customized Portal**.

FDM3622	FDMC2523P
FDMC2523P	FDMC2523P
FDMA1032CZ	FDMA1032CZ
FDMA410NZ	FDMA1032CZ

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN23381X

発行日: 05 Aug 2020

変更件名:	HANA セミコンダクターにおける QMI519 および ABLETHERM 8600 のエポキシ塗布から CDAF215 への変更認定										
初回出荷予定日:	12 Nov 2020 またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前.										
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または Naruedol.Srisamran@onsemi.com にお問い合わせください。										
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または PCN.samples@onsemi.com にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。										
追加の信頼性データ:	お客さまの地域のオン・セミコンダクター営業所または Lalan.Ortega@onsemi.com にお問い合わせください。										
通知種別:	これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) です。FPCN は、変更実施の 90 日前に発行されます。 オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 30 日以内に書面による問い合わせがない限り、この変更が承諾されたものとみなします。お問い合わせは、 PCN.Support@onsemi.com 宛てにお願いします。										
変更部品の識別:	今回の変更に伴う製品マーキングの変更はありません。										
変更カテゴリ:	組立の変更										
変更サブカテゴリ:	材料の変更										
影響を受ける拠点:											
オン・セミコンダクター拠点:	外部製造工場 / 下請業者拠点:										
無し	HANA Semiconductor, Thailand										
説明および目的:	<p>オン・セミコンダクターは、以下の表に示す、エポキシ材料の変更と、それに伴うプロセスフローの変更について、お客様にお知らせいたします。</p> <p>その他の材料は同じです:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>変更前の表記</th> <th>変更後の表記</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ダイ接着剤</td> <td>QMI519 または ABLETHERM 8600</td> <td>CDAF215</td> </tr> <tr> <td>その他の変更</td> <td>ダイ接着プロセスにおけるエポキシ塗布</td> <td>ウェハーバックグラインディングプロセスにおける DAF ラミネート</td> </tr> </tbody> </table> <p>今回の変更に伴う製品マーキングの変更はありません。</p>			変更前の表記	変更後の表記	ダイ接着剤	QMI519 または ABLETHERM 8600	CDAF215	その他の変更	ダイ接着プロセスにおけるエポキシ塗布	ウェハーバックグラインディングプロセスにおける DAF ラミネート
	変更前の表記	変更後の表記									
ダイ接着剤	QMI519 または ABLETHERM 8600	CDAF215									
その他の変更	ダイ接着プロセスにおけるエポキシ塗布	ウェハーバックグラインディングプロセスにおける DAF ラミネート									



信頼性データの要約:

デバイス名: FDMC2523P

RMS : F60209

パッケージ: WDFN8

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008hrs	0 / 231
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	96 hrs	0 / 231
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2.0 min	30,000 cycles	0 / 231
TC	JESD22-A104	Ta= -65°C to +150°C	500 cyc	0 / 231
AC	JESD22-A102	121°C, 100% RH, 15.5psig, unbiased	96 hrs	0 / 231
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C		0 / 924
RSH	JESD22- B106	Ta = 265°C, 10 sec		0 / 90
SD	JSTD002	Ta = 245°C, 10 sec		0 / 45
SAT	JEDEC STD 035	Pre and Post MSL 1		0 / 22
CDPA X Section	AEC- 006	Custom Destructive Physical Analysis – X section		0 / 6
DPA	AEC Q101	Destructive Physical Analysis post HAST 192hrs, TC 1000cycles		0 / 12

デバイス名: FDMA1032CZ

RMS : F60218

パッケージ: WDFN6

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	2016 hrs	0 / 77
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs	0 / 77
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2.0 min	30,000 cycles	0 / 77
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	2000 cyc	0 / 77
AC	JESD22-A102	121°C, 100% RH, 15.5psig, unbiased	96 hrs	0 / 77
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C		0 / 308
RSH	JESD22- B106	Ta = 265°C, 10 sec		0 / 30
SD	JSTD002	Ta = 245°C, 10 sec		0 / 15
SAT	JEDEC STD 035	Pre and Post MSL 1		0 / 22
CDPA X Section	AEC- 006	Custom Destructive Physical Analysis – X section		0 / 2
CDPA WP	MILSTD750 Method 2037	Wire Pull after TC1000 cycles, Cu wire		0 / 5
DPA	AEC Q101	Destructive Physical Analysis post HAST 192hrs, TC 1000cycles		0 / 4

**最終製品 / プロセス変更通知**

文書番号# : FPCN23381X

発行日: 05 Aug 2020

電気的特性の要約:

電気的特性への影響はありません。

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
FDM3622	FDMC2523P
FDMC2523P	FDMC2523P
FDMA1032CZ	FDMA1032CZ
FDMA410NZ	FDMA1032CZ